

关于举办第三届半导体行业用陶瓷材料技术研讨会的通知

半导体产业几乎关系到当今数字化时代所有与电子相关的领域, 是对国民经济极其重要的战略性产业。而与此同时, 美国及其盟友为争夺对全球半导体供应链的竞争优势, 对我国实施一系列技术封锁措施, 且趋势未见减缓。我国的半导体产业仍存在严峻的安全问题。

半导体行业之所以成为重资产行业, 最主要的原因就在于价格高昂的半导体设备, 在这些昂贵的半导体设备中, 精密陶瓷零部件的成本可达 10%左右, 当前该市场仍被欧美日发达国家垄断。因此, 实现精密陶瓷零部件的国产化替代是保障我国半导体产业供应链安全稳定与自主可控的重要环节。

在此背景下, 中国粉体网将在**江苏苏州举办第三届半导体行业用陶瓷材料技术研讨会**, 旨在为半导体和先进陶瓷行业搭建沟通平台, 交流先进技术, 互通行业信息, 促进产业链合作, 推动国产替代进程。

会议热诚欢迎行业专家、学者、技术人员、企业界代表出席, 同时欢迎公司、企事业单位展示技术成果, 洽谈产、学、研合作。

主办单位:



会议主题:

- 1、符合行业要求的高端粉体、成型、烧结、机械加工技术
- 2、符合行业要求的氧化物、碳化物、氮化物、堇青石等陶瓷制品性能

- 3、半导体行业用先进陶瓷产品市场规模及国产化前景
- 4、电动汽车、5G、人工智能等热点应用领域及新兴市场分析

特色活动:

大会征集参会企业相关技术合作、产品采购,工艺方案等需求进行现场采配活动,相关信息将进行展板展示,提高现场沟通交流效率!

征集内容包含但不限于以下几点:

- 1、行业投资、融资需求
- 2、科研成果转化
- 3、产品工艺问题解决方案
- 4、原料、设备、仪器采购需求

时间 地点

2024 年 4 月 25 日, 4 月 24 日报到
苏州 白金汉爵大酒店(相城店)
苏州市相城区相城大道 1111 号

会议费用:

2800 元/人

付款账户:

户名	山东中粉会展服务有限公司
开户行	中国银行股份有限公司临沂北城支行
帐号	233841636876

会务组:

联系人: 任经理
联系方式: 18660985530 (同微信)

